



## Tagesordnung

Thema: 70. Treffen des Arbeitskreises  
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und  
Verbindungstechnologien“

Datum: **17. Februar 2021, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin  
Online via MS Teams

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
Analysen der Lotermüdung an montierten Testbaugruppen unter  
Thermowechselbeanspruchungen  
*Herr Dr. Dudek, Fraunhofer ENAS, Chemnitz*
- 3 10:50 Uhr  
Sichere Prozessierung von Bottom Termination Components am Beispiel von  
01005 Dioden – Vom empfohlenen Pad-Design zum zuverlässig gelöteten  
Bauteil  
*Herr Schimanski, Fraunhofer ISIT, Itzehoe*
- 4 11:30 Uhr  
Leiterplattenbasierte Sensoren zur Überwachung und Früherkennung von  
Korrosionsschäden  
*Herr Prof. Nowotnick, Uni Rostock, Rostock*
- 5 12:10 Uhr  
Mittagessen

- 6            13:10 Uhr  
Kontaktthermografie - eine vielversprechende Methode zur zerstörungsfreien  
Inspektion von Löt- und Sinterverbindungen  
*Herr Dr. Oppermann, TU Dresden, TU Dresden*
- 7            13:50 Uhr  
Aktuelle Untersuchungsergebnisse zur Entstehung und Vermeidung der Wicking-  
Defekte beim Löten von Steckverbindern  
*Herr Wild, Rehm Thermal Solutions, Blaubeuren-Seißen*
- 8            14:30 Uhr  
Kaffeepause
- 9            15:00 Uhr  
Thermische Beurteilung von THT-Lötstellen-designs für die IPC-konforme  
Kontaktierung durch Selektivlöten  
*Herr Seidel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg*
- 10           15:40 Uhr  
Kontrolle und Simulation von Verwölbung in der Systemintegration  
*Herr Dr. Wittler, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 11           16:20 Uhr  
Abschlussdiskussion  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**